



株式会社 新 川
ニュースリリース

2014 年 3 月 11 日

ディスクリート用共晶ダイボンダ新機種 STC-800 受注開始

株式会社新川（社長：西村浩、東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番地の 1）は、ディスクリート用共晶ダイボンダの最新鋭機種「STC-800」の開発を完了し、受注を開始しました。

ディスクリート分野では、パッケージの小型化に伴い、高精度ボンディングに対する要求が高まっています。同機種では精度 $\pm 20\mu\text{m}$ (3σ) を実現するとともに、パッケージコストダウンに寄与するリードフレームの幅広化および多列取りに対応すべく、Y 方向ボンディングエリアを拡大しました。また、高速駆動により生産性を従来機比 10%向上するなど、ディスクリート生産の品質・コスト両面に寄与する装置となっています。



【ダイボンダ STC-800】

【STC-800 の特長】

- (1) ボンディング精度 $\pm 20\mu\text{m}$ (3σ)
- (2) 従来機比UPH10%向上
- (3) リニア駆動の採用により、高精度なリードフレーム搬送が可能
- (4) 幅86mmまでのフレームに対応し、Yボンディングエリア76mmまでの実装が可能
- (5) 長期安定稼働を実現する自己診断機能を搭載
- (6) ウェーハシート引伸ばし量のパラメータ設定、ダイ認識用カメラのズーム機能などにより、多様なデバイス条件に対応可能

ディスクリート用共晶ダイボンダ「STC-800」は、Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)で開催されるSEMICON China 2014（2014年3月18日から20日まで開催）に出展します。

なお、ダイボンダでは、メモリ用機種の開発を進めており、2014年度に商品化する予定です。

■ その他当社取扱製品

ワイヤボンダ、フリップチップボンダ、バンプボンダ等

■ お問い合わせ先

お客様お問い合わせ担当：営業本部 北林 靖基（TEL：042-560-1225）

報道機関お問い合わせ担当：経営企画部 森 琢也（TEL：042-560-4848）

以上

株式会社 新 川

〒208-8585 東京都武蔵村山市伊奈平 2-51-1